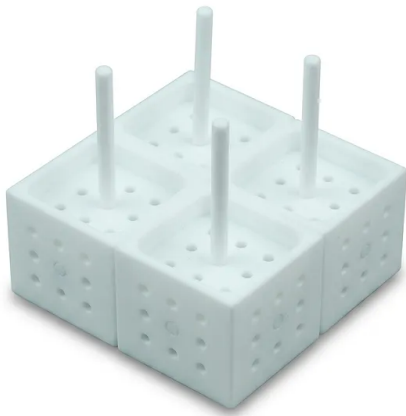


Panier Fleur De Nettoyage De Tranches En Ptfé Sur Mesure, Porteur En Fluoropolymère Résistant Aux Produits Chimiques Pour La Gravure Des Semi-Conducteurs Et Le Traitement Des Nouvelles Énergies

Numéro d'article: PL-CP149



Introduction

Optimisez votre fabrication de semi-conducteurs et de nouvelles énergies avec des paniers fleurs de nettoyage de tranches en PTFE sur mesure. Conçus pour une résistance chimique extrême pendant la gravure et le nettoyage RCA, ces porteurs en fluoropolymère de haute pureté garantissent l'intégrité du processus et une durabilité à long terme dans des environnements industriels exigeants.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage Clé
Nettoyage RCA des Semi-conducteurs	Nettoyage séquentiel des tranches de silicium à l'aide des solutions SC-1 et SC-2 pour éliminer les contaminants organiques et métalliques.	Zéro contamination et résistance aux mélanges ammoniac/péroxyde.
Gravure à l'Acide Fluorhydrique (HF)	Élimination des oxydes natifs ou gravure contrôlée des couches de dioxyde de silicium sur les surfaces des tranches.	Résistance absolue au HF, qui dissoudrait les alternatives en verre ou quartz.
Texturation Photovoltaïque	Gravure chimique humide des tranches de silicium monocristallin ou polycristallin pour créer des surfaces piégeant la lumière.	L'alignement constant des fentes garantit une texturation uniforme sur de grands lots.
Traitement à la Solution Piranha	Élimination agressive des résidus organiques et du photorésist à l'aide d'acide sulfurique et de peroxyde d'hydrogène.	Résiste aux réactions exothermiques extrêmes et à l'acidité à haute température.
Rinçage Post-CMP	Nettoyage critique des tranches après le polissage chimico-mécanique pour éliminer les boues abrasives.	Les surfaces lisses et le drainage élevé empêchent la redéposition des particules.
Préparation des Semi-conducteurs Composés	Nettoyage spécialisé des tranches de GaAs ou InP pour la fabrication avancée de dispositifs électroniques et optoélectroniques.	Géométrie de fente personnalisable pour des épaisseurs et tailles de tranches non standard.
Chargement de Réacteur à Microcanaux	Positionnement des substrats dans des chambres de réaction personnalisées pour un dépôt en phase vapeur ou liquide contrôlé.	Les dimensions sur mesure permettent un ajustement parfait dans les configurations de laboratoire sur mesure.
Développement de Lithographie	Maintien des substrats pendant le développement et l'enlèvement des couches de photorésist dans les flux de travail de microfabrication.	La résistance aux solvants garantit que le porteur ne se dégrade pas ni ne dégage pendant le processus.

Paramètre	Détail des Spécifications pour PL-CP149
Identifiant du Modèle	Série PL-CP149
Construction Matérielle	PTFE (Polytétrafluoroéthylène) Vierge Haute Pureté 100%
Méthode de Fabrication	Usinage CNC Entièrement Personnalisé
Compatibilité Chimique	Universelle (Acides, Bases, Solvants, Oxydants, HF)
Plage de Température de Fonctionnement	-200°C à +260°C (-328°F à +500°F)

Application	Description	Avantage Clé
Paramètre	Détail des Spécifications pour PL-CP149	
Compatibilité des Tranches	Personnalisable pour 2", 3", 4", 6", 8", 12" ou tailles non standard	
Configuration des Fentes	Entièrement Personnalisable (Pas, largeur et profondeur variables)	
Nombre de Fentes	Défini selon l'exigence du client (ex : capacité de 10, 25, 50)	
Conception de la Poignée	Intégrée, Amovible ou Allongée (Longueur personnalisable)	
Finition de Surface	Finition usinée lisse, à faible porosité	
Norme de Pureté	Adaptée à l'Analyse de Traces et à l'utilisation en Salle Blanche Classe 10/100	
Caractéristiques de Drainage	Orifices de drainage inférieurs/latéraux personnalisables	